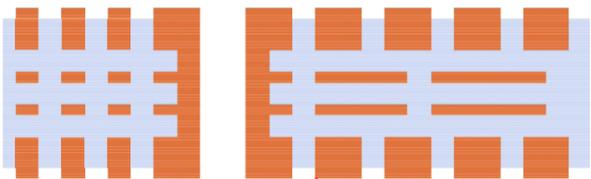
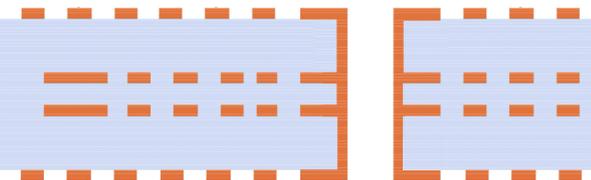
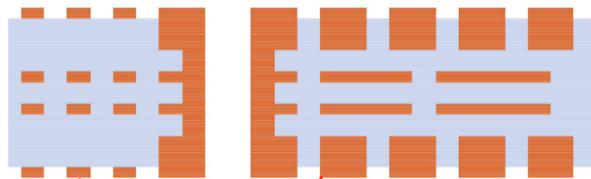


展示No	区分	<input checked="" type="checkbox"/> 部品 <input type="checkbox"/> 素材/材料 <input type="checkbox"/> 設備/装置 <input type="checkbox"/> 金型/治工具 <input type="checkbox"/> システム/ソフトウェア <input type="checkbox"/> その他()			
09-1	提案名	異種導体厚混在基板による パワー回路と制御の統合基板		工法 多層PCB	新規性 世界初
会社名	日本シイエムケイ(株)		所在地	東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー43F	
連絡先	部署名: 営業本部 開発営業部		URL	: http://www.cmk-corp.com	
	担当名: 石塚 雅之		Tel No.	: 080-7339-9343	
	主要取引先		海外対応	海外拠点	
	株式会社デンソー		<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 有(タイ、中国)	

<< 提案内容 >>

提案の狙い <input checked="" type="checkbox"/> 原価低減 <input checked="" type="checkbox"/> 軽量化 <input checked="" type="checkbox"/> 生産(作業)性向上 <input checked="" type="checkbox"/> 品質/性能向上 <input type="checkbox"/> 安全/環境対策/CN対応 <input checked="" type="checkbox"/> その他(異種機能部品の統合化)	適用可能な製品/分野 車載機器(統合ECU) インバータ関連の大電流機器																								
従来	新技術・新工法																								
大電流パワー回路基板  制御系回路基板  従来は大電流と制御回路を別個の基板で作製	異種導体厚混在基板  「制御系回路部」 「大電流パワー回路部」(厚銅・高放熱) 回路ルール <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>導体厚</th> <th>ライン/スペース</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>パワー回路</td> <td>500um</td> <td>800/800um</td> </tr> <tr> <td>制御系回路</td> <td>100um</td> <td>150/300um</td> </tr> </tbody> </table> 適性 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>放熱性</th> <th>大電流化</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>銅インレイ基板</td> <td align="center">◎</td> <td align="center">×</td> </tr> <tr> <td>銅ベース基板</td> <td align="center">◎</td> <td align="center">×</td> </tr> <tr> <td>銅コア基板</td> <td align="center">◎</td> <td align="center">○</td> </tr> <tr> <td>本開発品</td> <td align="center">◎</td> <td align="center">◎</td> </tr> </tbody> </table>		導体厚	ライン/スペース	パワー回路	500um	800/800um	制御系回路	100um	150/300um		放熱性	大電流化	銅インレイ基板	◎	×	銅ベース基板	◎	×	銅コア基板	◎	○	本開発品	◎	◎
	導体厚	ライン/スペース																							
パワー回路	500um	800/800um																							
制御系回路	100um	150/300um																							
	放熱性	大電流化																							
銅インレイ基板	◎	×																							
銅ベース基板	◎	×																							
銅コア基板	◎	○																							
本開発品	◎	◎																							
セールスポイント(製造可能な精度/材質等) <ul style="list-style-type: none"> 大電流回路基板と制御回路基板の2枚の基板を統合化し、1枚の基板として実装・組付が可能 基板間接続のコネクタ/ハーネスが不要 	問題点(課題)と対応方法 原材料の厚銅板の調達																								
開発進度 (2024年 8月 現在) <input type="checkbox"/> アイデア, <input checked="" type="checkbox"/> 試作/実験, <input type="checkbox"/> 開発完了, <input type="checkbox"/> 製品化完了	特許の有無 出願中																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>コスト</th> <th>軽量化</th> <th>生産/作業性</th> <th>その他(省スペース)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>従来との比較</td> <td align="center">10%低減</td> <td align="center">20%低減</td> <td align="center">50%向上</td> <td align="center">20%低減</td> </tr> </tbody> </table>	項目	コスト	軽量化	生産/作業性	その他(省スペース)	従来との比較	10%低減	20%低減	50%向上	20%低減															
項目	コスト	軽量化	生産/作業性	その他(省スペース)																					
従来との比較	10%低減	20%低減	50%向上	20%低減																					